

セラミック RF デバイス

■ 使用上の注意

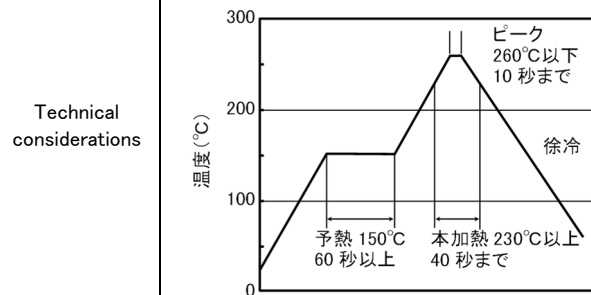
1. 基板設計

◆ランドパターンの設計 ランドパターン寸法例

管理ポイント	TSD1M15H/TSL1N15H LGA 6Pins type	TSB1N15H/TSL1N15H Side 4Pins type	TSB1N18F Side 4Pins type	TSB1N18D/TSL1N18D /TSH1N18D LGA 3Pins type
	単位: mm	単位: mm	単位: mm	単位: mm
	TSD1N18B LGA 6Pins type	TSD1N18D/TSL1N18D /TSC1N18D Side 6Pins type	TSC4N18F Side 8Pins type	TSB1N21D LGA 3Pins type
	単位: mm	単位: mm	単位: mm	単位: mm
	TSD1N21A829MLS0G2T /TSD1N21C LGA 6Pins type	TSD1N21 LGA 6Pins type	TST1N22D LGA 9Pins type	
単位: mm	単位: mm	単位: mm		

2. はんだ付け

◆リフローはんだ付け条件(参考用) ・PB フリーリフロープロファイル



※ チップとはんだ温度との差が 100~130°C 以下になるように十分予熱を行ってください。
※ 回数は 2 回迄の保証となります。

注: 左記温度プロファイルは最大許容条件であり、常にこれを推奨するものではありません。

3. 貯蔵・保管

注意点	<p>◆貯蔵・保管</p> <ol style="list-style-type: none">1. 本品は以下の環境で貯蔵・保管しないで下さい。<ul style="list-style-type: none">・ 特殊ガス雰囲気 (C12、NH3、SOx、NOx など)・ 揮発性・引火性のあるガス雰囲気・ ほこりの多いところ・ 直接水がかかるところ、多湿のため結露しやすい場所・ 直射日光の当る場所、凍結する場所2. 下記の条件での保管をお願いします。<ul style="list-style-type: none">・ 温度: -10~+40°C・ 湿度: 15~85%RH3. 納入後 6ヶ月以内にご使用ください。尚、6ヶ月以上経過したものを使用する場合は、使用前にはんだ付け性の確認をお願いします。
<p>■ 仕様の詳細については、別に用意してありますので、各営業所までお問い合わせください。 なお、ここに記載された規格値は、改良のために予告なく変更されることがあります。 従って、納入仕様書等を十分ご確認の上、ご使用の程お願い申し上げます。</p>	